

苏州锆威特半导体股份有限公司 关于向控股子公司提供财务资助的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次财务资助对象为苏州锆威特半导体股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司无锡众享科技有限公司（以下简称“众享科技”），资助方式为公司向众享科技提供额度不超过 1,000 万元的借款，借款期限为自本次董事会审议通过之日起 12 个月，年固定利率为 2.2%，利息按照借款对象实际借款占用天数计算。

● 本次财务资助事项已经公司于 2026 年 3 月 6 日召开的第三届董事会第五次会议审议通过，无需提交公司股东会审议。本次财务资助对象为公司合并报表范围内控股子公司，不构成关联交易。

● 公司本次提供财务资助对象为合并报表范围内的控股子公司，公司可以掌握资助资金的使用情况，风险可控。本次借款资金为公司自有资金，不影响公司正常业务开展及资金使用，不属于《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等规定的不得提供财务资助的情形。

一、财务资助事项概述

（一）财务资助的基本情况

为满足众享科技业务发展资金需求，公司拟在不影响自身正常业务开展及资金使用的情况下，向众享科技提供额度不超过人民币 1,000 万元的借款，期限自本次董事会审议通过之日起 12 个月，年固定利率为 2.2%，利息按照借款对象实际借款占用天数计算。

被资助对象名称	无锡众享科技有限公司
资助方式	<input checked="" type="checkbox"/> 借款 <input type="checkbox"/> 委托贷款 <input type="checkbox"/> 代为承担费用 <input type="checkbox"/> 其他_____
资助金额	不超过 1,000 万元
资助期限	12 个月
资助利息	<input type="checkbox"/> 无息 <input checked="" type="checkbox"/> 有息，年固定利率为 2.2%
担保措施	<input checked="" type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/> 有，_____

（二）内部决策程序

公司于 2026 年 3 月 6 日召开第三届董事会第五次会议审议通过了《关于向控股子公司提供财务资助的议案》，属于董事会审批权限范围，无需提交公司股东会审议。

董事会授权公司管理层办理与本次事项相关的协议签署、财务资助款项的支付以及签署未尽事项的补充协议等事宜。

（三）提供财务资助的原因

本次财务资助主要是为了满足众享科技业务发展资金需求，属于正常经营需要，不存在损害公司及股东利益的情形。本次财务资助事项不会影响公司正常生产经营及资金使用。

本次对控股子公司提供财务资助不属于《上海证券交易所科创板股票上市规则》规定的不得提供财务资助的情形。

二、被资助对象的基本情况

（一）基本情况

被资助对象名称	无锡众享科技有限公司
法定代表人	吉巍
统一社会信用代码	91320214MA1MWLPW1Y
成立时间	2016-10-09

注册地	无锡市滨湖区蠡园开发区吟白路1号研创大厦13楼1306	
主要办公地点	无锡市滨湖区蠡园开发区吟白路1号研创大厦13楼1306	
注册资本	1,020.41 万元	
主营业务	一般项目：科技推广和应用服务；集成电路芯片及产品销售；集成电路设计；集成电路芯片设计及服务；电力电子元器件销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；集成电路销售；电子产品销售；集成电路芯片及产品制造；半导体分立器件销售；半导体分立器件制造；货物进出口；技术进出口；科技中介服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）	
主要股东或实际控制人	公司持股 51%	
与上市公司的关系	<input checked="" type="checkbox"/> 控股子公司（其他股东是否有关联方： <input type="checkbox"/> 是， <input checked="" type="checkbox"/> 否） <input type="checkbox"/> 参股公司（其他股东是否有关联方： <input type="checkbox"/> 是， <input type="checkbox"/> 否） <input type="checkbox"/> 其他：_____	
主要财务指标（万元）	项目	2025 年 12 月 31 日/2025 年度（未经审计）
	资产总额	4,449.93
	负债总额	2,149.22
	资产净额	2,300.71
	营业收入	5,029.95
	净利润	-160.73
是否存在影响被资助人偿债能力的重大或有事项（包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项等）	<input checked="" type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/> 有，_____	

（二）被资助对象的资信或信用等级状况

众享科技不属于失信责任主体，亦不是失信被执行人。

（三）与被资助对象的关系

众享科技为公司控股子公司，股权结构如下：

股东名称	注册资本 (人民币万元)	持股比例	关联关系
苏州锴威特半导体股份有限公司	520.41	51.00%	/
吉巍	202.50	19.84%	无关联关系

无锡众享芯诚咨询管理合伙企业（有限合伙）	125.00	12.25%	无关联关系
无锡众志成城芯技术咨询合伙企业（有限合伙）	92.50	9.06%	无关联关系
徐舜	80.00	7.84%	无关联关系
合计	1,020.41	100.00%	/

（四）其他股东未按出资比例提供财务资助的说明

鉴于众享科技其他股东的资金情况，本次财务资助事项中，其他股东未按出资比例提供财务资助或担保。本次财务资助对象为公司的控股子公司，公司对其具有实质的控制和影响力，能够对其实施有效的业务、资金管理和风险控制，确保公司资金安全。本次财务资助事项整体风险可控，也不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。

三、财务资助协议的主要内容

甲方（出借方）：苏州锴威特半导体股份有限公司

乙方（借款方）：无锡众享科技有限公司

（一）借款币种与金额

甲方同意向乙方提供借款不超过 1,000 万元人民币。甲方可通过银行转账或银行承兑汇票的方式，向乙方提供前述借款。

（二）借款期限

1、借款期限为自甲方董事会审议通过之日起 12 个月。

2、本借款合同到期后，甲乙双方可视情况协商延长借款期限，经履行相应审议程序后另行签订补充协议。

（三）借款用途

借款指定用于乙方开展日常业务，乙方不得挪作他用，不得用借款进行违法活动。

（四）借款利率

1、本合同项下借款利率为固定利率，借款年利率为 2.2%，本合同项下利息按照借款对象实际借款占用天数计算。

2、乙方应于借款期到期前，一次性向甲方支付全部利息。

（五）违约责任

1、乙方有下列行为之一的，属于违约，甲方有权单方面宣布合同项下已发放的借款提前到期并要求乙方立即偿还所有借款本金：

(1) 乙方未按本合同第（三）条约定使用借款；

(2) 乙方违反法律法规的约定使用借款；

(3) 乙方未按本合同的约定按期足额偿还本金；

(4) 乙方向甲方提供的信息或资料不真实，或者拒绝接受甲方对其使用借款情况及经营情况等的监督。

2、乙方逾期归还或拒绝按本合同约定归还本金的，每逾期一日，应按逾期金额的万分之五向甲方支付违约金。

3、乙方未按时足额偿还借款本金的，应当承担甲方为实现债权而支付的所有费用，该费用包括但不限于诉讼费、律师费和所有其他应付合理费用。

四、财务资助风险分析及风控措施

众享科技为公司控股子公司，公司对其业务、资金及财务拥有实质控制权，可有效实施风险控制并保障资金安全，不会对公司日常经营产生重大影响。鉴于其他股东的资金情况，其后续不会按出资比例提供财务资助或担保。本次财务资助公司拟采用有偿、公允借款方式，决策程序合法合规，不存在向关联方输送利益的情形，不会损害公司及全体股东特别是中小股东的利益。公司将密切关注其经营、财务状况及偿债能力，加强资金使用监管，积极防范风险。

五、董事会意见

本次财务资助主要用于支持控股子公司的业务发展，符合公司整体利益。在不影响自身正常业务开展及资金使用的情况下，有利于提高公司整体资金使用效率，整体风险可控，利率公平合理，不存在损害公司及公司股东、特别是中小股东利益的情形。

六、累计提供财务资助金额及逾期金额

项目	金额（万元）	占上市公司最近一期经审计净资产的比例（%）
----	--------	-----------------------

上市公司累计提供财务资助余额	0	0
对合并报表外单位累计提供财务资 助余额	0	0
逾期未收回的金额	0	0

特此公告。

苏州锴威特半导体股份有限公司董事会

2026年3月7日